

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2016-007

金安国纪科技股份有限公司

签署《关于杭州联合电路板有限公司之股权转让框架协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

2016年2月21日，金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）、杭州联合电路板有限公司及田军先生签署了《关于杭州联合电路板有限公司之股权转让框架协议》。公司拟对田军所持有的杭州联合电路板有限公司（以下简称“杭州联合电路板”）100%股权进行收购。

本次股权收购不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易标的基本情况

杭州联合电路板是一家根据中国法律合法设立的自然人独资的有限责任公司，住所为浙江省临安市锦城镇，经营范围为：生产、销售：印刷电路板。

田军先生是杭州联合电路板的唯一股东，持有杭州联合电路板100%股份。杭州联合电路板和田军先生是与公司无关联关系的独立第三方。

三、框架协议的主要内容

1、公司拟收购田军先生所持有的杭州联合电路板100%股权。

2、各方确认本次交易的最终价格以评估机构出具评估报告中载明的100%股权的股权价值作为作价依据，由交易各方最终协商确定。

3、本框架协议签订后杭州联合电路板及田军不得再就本标的股权的出售，直接或间接地与任何其他单位或人士进行洽谈、联系，或向其索取或诱使其提出要约，或与其进行其他任何性质的接触。

4、本框架协议自各方或其授权代表签字盖章并经金安国纪董事会批准后生效。

5、除非法律、法规或规范性文件另有规定，未经一方事先同意，任何一方

不得披露本框架协议提到的相关事项。

四、本次收购的目的

本次收购主要为公司覆铜板新产品试验担负实验工厂的作用。通过 PCB 生产比较成熟的杭州联合电路板在 PCB 行业中对公司研发的覆铜板新产品进行试用和完善，直接接触 PCB 下游客户（覆铜板产品的直接使用客户），使公司研发出更多、更新、性价比更高、能适应各种客户需求的覆铜板新产品，进一步扩大中高等级覆铜板产品的市场份额，以实现强化公司规模优势和行业影响力的目的。

五、风险提示

上述框架协议的签署，仅确定有关各方的意向及初步洽谈的结果，需经董事会审议通过后才正式生效。协议项下股权收购事宜的实施尚需进一步协商谈判并签订相关正式的协议或合同，因此，该股权收购事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将严格按照相关规定和要求履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。

六、备查文件

《金安国纪科技股份有限公司与田军关于杭州联合电路板有限公司之股权转让框架协议》

特此公告。

金安国纪科技股份有限公司

董事会

二〇一六年二月二十二日